



SOLUÇÕES EM LIMPEZA NA ÁREA DE ELETRÔNICA

Trabalhamos com solventes não-inflamáveis ou nível de inflamabilidade segura para a indústria

- Substitutos diretos do IPA (álcool isopropílico), para aplicações em geral
- Limpeza de stencil com pasta de solda: manual, Screen Printers, ultrassom e spray-in-air
- Limpeza de stencil com adesivo não-curado (stencil metal e pump print)
- Limpeza de misprint (placas com erro de impressão de pasta de solda), sem uso de pano ou contato mecânico
- Limpeza de resíduos pós-montagem em PCI, retrabalho
- Lavagem de pallets e outras peças com fluxo de solda
- Manutenção: produtos para limpeza local em fornos de refusão, remoção de fluxo



Envoy São Paulo
Rua Dr. Luiz Migliano, 225 - Jd. Vazani
05711-000 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3742-5050
envoy@envoy.com.br

Envoy Manaus
Av. Pres. Castelo Branco, 1016 - piso 01
sala 01 - CEP 69065-01 - Manaus - AM
Tel: (92) 3233-3002
envoy@envoy.com.br

Aplicação / Produto e concentração	C8622	C8882*	A8830	C8508	E5314	E5611	E5321	A4625B	I3302
STENCILS									
Limpeza de pasta de solda em Stencil (manual)	100%	100%							
Limpeza de pasta de solda em Stencil (ultrassom manual)	100%	100%							
Limpeza de pasta de solda em Stencil (ultrassom imersão)			15%		15%				
Limpeza de pasta de solda em Stencil (Screen Printer)	100%	100%							
Lavagem de pasta de solda (Spray-in-air)	100%					25%			
Limpeza manual de ADESIVO não-curado Stencil / PCI		100%							
Lavagem de adesivo não-curado (spray-in-air)		100%				≥ 25%			
PLACAS (PCB)									
Limpeza manual de resíduos de fluxo em PCB	100%	100%							100%
Lavagem de resíduos de fluxo em PCB (Spray-in-air)	100%	100%						25%	
Lavagem de Misprint em PCB (Spray-in-air)	100%	100%				25%		25%	
Limpeza de Misprint em PCB (ultrassom imersão)	100%	100%	15%		25%				100%
Limpeza manual de Misprint (banho, borrifador)		100%							
Limpeza manual de adesivo não-curado em PCB		100%							
MANUTENÇÃO - FORNOS / PALLETS									
Remoção de fluxo em fornos de refusão, outras peças c/ fluxo				100%					
Lavagem (banho) de PALLETS, remoção de fluxo					25%		10%		
Lavagem de peças com fluxo: radiadores, fingers, etc					25%		10%		
Lavagem de nozzles e squeegees (remoção de pasta de solda)	100%	100%	25%		25%				

* C8882 é o novo nome do I3419